

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2004-307906

(43)Date of publication of application : 04.11.2004

(51)Int.Cl.

C23C 14/34

(21)Application number : 2003-100782

(71)Applicant : KOBELCO KAKEN:KK

(22)Date of filing : 03.04.2003

(72)Inventor : MATSUMURA HITOMI
YONEDA YOICHIRO

(54) SPUTTERING TARGET, AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a very large sputtering target obtained by butt-welding metal plates of the same quality in which the grain size and the dispersed state of metal crystals and intermetallic compounds are substantially equal between a welded zone and a non-welded zone.

SOLUTION: The mean grain size of intermetallic compounds of a welded zone is 60-130% of the mean grain size of intermetallic compounds of a non-welded zone.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.12.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's
decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-307906

(P2004-307906A)

(43) 公開日 平成16年11月4日(2004.11.4)

(51) Int.Cl.⁷

C23C 14/34

F1

C23C 14/34

A

テーマコード(参考)

4K029

審査請求 未請求 請求項の数 11 O L (全 13 頁)

(21) 出願番号

特願2003-100782(P2003-100782)

(22) 出願日

平成15年4月3日(2003.4.3)

(71) 出願人

000130259

株式会社コベルコ科研

兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号

(74) 代理人

100067828

弁理士 小谷 悦司

(74) 代理人

100075409

弁理士 植木 久一

(72) 発明者

松村 仁実

兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目3番1号

株式会社神戸製鋼所高砂製作所内

(72) 発明者

米田 陽一郎

兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目3番1号

株式会社神戸製鋼所高砂製作所内

Fターム(参考) 4K029 DC01 DC02 DC04 DC09

(54) 【発明の名称】 スパッタリングターゲットおよびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】同質の金属板を突合せ接合して得られるスパッタリングターゲットであって、金属結晶や金属間化合物の粒径・分散状態が、接合部と非接合部でほぼ同程度である特に大型のスパッタリングターゲットを提供する。

【解決手段】接合部の金属間化合物の平均粒径が、非接合部の金属間化合物の平均粒径の60～130%であることを特徴とするスパッタリングターゲット。